证券代码：688508　　证券简称：芯朋微　　公告编号：2026-075

无锡芯朋微电子股份有限公司

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2026/10/27
回购方案实施期限	2026 年 10 月 26 日~2027 年 1 月 25 日
预计回购金额	1,500万元~3,000万元
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	102,539股
累计已回购股数占总股本比例	0.08%
累计已回购金额	4,999,743.67元
实际回购价格区间	47.50元/股~50.00元/股

一、 回购股份的基本情况

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益，该用途下回购的股份未来拟出售。回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 114.42 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日、2026 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-070）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-074）。

公司已取得中信银行股份有限公司无锡分行出具的《贷款承诺函》，贷款金额最高不超过人民币 2,700 万元，贷款期限最长不超过 3 年，贷款用途专项用于回购公司股票。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-073）。

二、 回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：

2026 年 11 月 20 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 102,539 股，占公司总股本的比例为 0.08%，回购成交的最高价为 50.00 元/股，最低价为 47.50 元/股，支付的资金总额为人民币 4,999,743.67 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

三、 其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日